

SMコンタクト

SM contact

SM-A364030A



- 材 質 /Material ベリリウム銅 (t=0.1mm) Beryllium copper (t=0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ =2.2 ~ 3.4mm Height: 2.2 mm to 3.4 mm

用途

Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

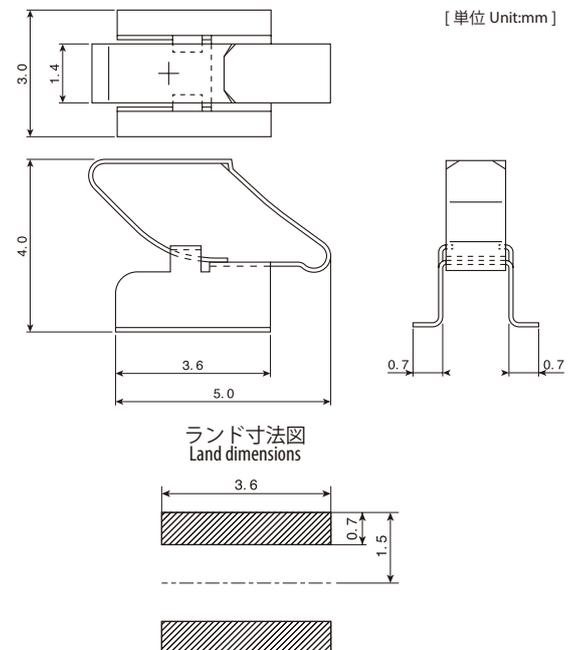
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	2,500ヶ (リール) 2,500/reel	実数2,502ヶ (2ヶ予備) Actual quantity: 2,502 (two spares)
ダンボール Corrugated cardboard	30,000ヶ (外箱) 30,000/box	12リール/1箱 梱包 Twelve reels are packed in each box.

* 外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



特性

Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	2.6N以下 2.6 N or less	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mmに圧縮した時の反発力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65℃/95% RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100 サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	25% 以下 25% or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)の IPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。 半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3 sec.

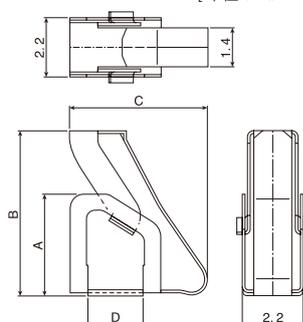
SMコンタクト
SM contact

SM-V series



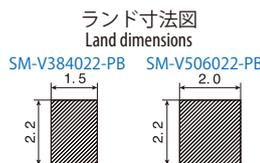
- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range **SM-V384022-PB**
高さ = 2.5 ~ 3.8mm Height: 2.5 mm to 3.8 mm
SM-V506022-PB
高さ = 3.7 ~ 5.8mm Height: 3.7 mm to 5.8 mm

[単位 Unit:mm]



用途 Applications

▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



品番表 Product list

品番 Product code	寸法 [mm] Dimensions [mm]				標準梱包数量 Standard packaging quantity	
	A	B	C	D	テーピング Taping	ダンボール Corrugated cardboard
SM-V384022-PB	2.3	4.0	3.75	1.5	5,000ヶ (リール) /実数5,001ヶ(1ヶ予備) 5,000/reel; Actual quantity: 5,001 (one spare)	60,000ヶ (外箱) 12リール/1箱 梱包 60,000/box (12 reels are packed in each box.)
SM-V506022-PB	3.7	6.0	5.0	2.0	1,500ヶ (リール) 1,500/reel	21,000ヶ (外箱) 14リール/1箱 梱包 21,000/box (14 reels are packed in each box.)

特性 Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.05Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	1.0N以下 (SM-V384022-PB) 1.0 N or less (SM-V384022-PB) 2.6N以下 (SM-V506022-PB) 2.6 N or less (SM-V506022-PB)	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の反発力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：65℃/95%RH 処理時間：500hr
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：100 サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 (SM-V384022-PB) 30% or less (SM-V384022-PB) 25%以下 (SM-V506022-PB) 25% or less (SM-V506022-PB)	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0：初期高さ t1：処理後高さ t2：スパーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田：PF305 フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3 sec.

SMコンタクト

SM contact

SM-485030-I



- 材 質 /Material..... リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze (t = 0.08 mm)
- メッキ処理 /Plating..... 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ =2.1 ~ 4.8mm Height: 2.1 mm to 4.8 mm

用 途

Applications

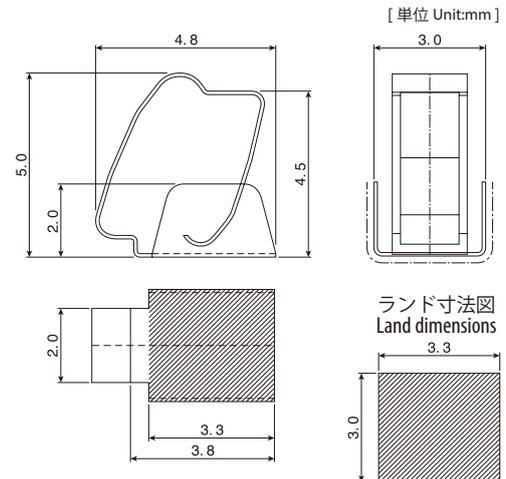
- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	2,000ヶ (リール) 2,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	28,000ヶ (外箱) 28,000/box	14リール / 1箱 梱包 Fourteen reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



特 性

Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件																					
初期抵抗値 Initial resistance	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。																					
圧縮荷重 Compressive load	0.5N ~ 1.2N 以下 0.5 N to 1.2 N	測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mm~2.7mmに圧縮した時の反発力を測定する。																					
		測定方法 製品を測定用基盤に半田付けし、製品高さを2.7mmに圧縮した時と4.7mmに圧縮した時の荷重をプッシュプルゲージを使用し手作業で測定する。																					
測定結果		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>サンプル1</th> <th>サンプル2</th> <th>サンプル3</th> <th>サンプル4</th> <th>サンプル5</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.7mm 時</td> <td>0.6N</td> <td>0.5N</td> <td>0.5N</td> <td>0.6N</td> <td>0.6N</td> <td>0.56N</td> </tr> <tr> <td>2.7mm 時</td> <td>1.2N</td> <td>1.1N</td> <td>1.1N</td> <td>1.2N</td> <td>1.1N</td> <td>1.14N</td> </tr> </tbody> </table>		サンプル1	サンプル2	サンプル3	サンプル4	サンプル5	平均	4.7mm 時	0.6N	0.5N	0.5N	0.6N	0.6N	0.56N	2.7mm 時	1.2N	1.1N	1.1N	1.2N	1.1N	1.14N
	サンプル1	サンプル2	サンプル3	サンプル4	サンプル5	平均																	
4.7mm 時	0.6N	0.5N	0.5N	0.6N	0.6N	0.56N																	
2.7mm 時	1.2N	1.1N	1.1N	1.2N	1.1N	1.14N																	
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr																					
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65℃/95% RH 処理時間: 500hr																					
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr																					
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100 サイクル																					
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30% 以下 30% or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー																					
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。 半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3 sec.																					

SMコンタクト

SM contact

SM-Z365325-PB



- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.15mm) Phosphor bronze (t = 0.15 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ = 3.4 ~ 5.0mm Height: 3.4 mm to 5.0 mm

用途

Applications

- ▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

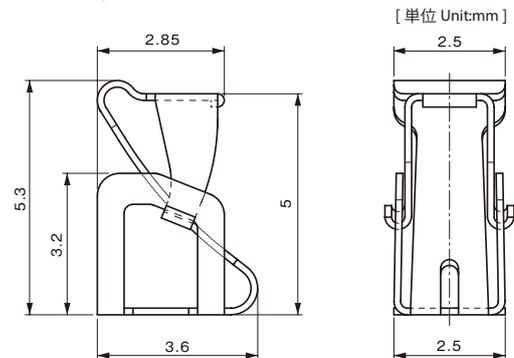
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

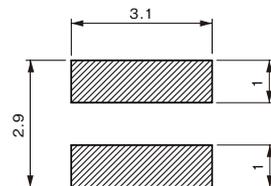
Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	2,000ヶ (リール) 2,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	30,000ヶ (外箱) 30,000/box	15リール/1箱 梱包 Fifteen reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



ランド寸法図
Land dimensions



特性

Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.05Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基板上に半田付けし、製品を4.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	5N以上 5 N or more	測定用基板上に半田付けし、製品を4.0mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：60℃/95%RH 処理時間：500hr
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。 処理温度：-40℃(3hr)~85℃(3hr) 処理時間：12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田：PF305 フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。 半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3sec.

SMコンタクト

SM contact

SM-D series



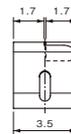
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)
- メッキ処理 / Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 / Recommended operating range SM-D733735-PB
高さ = 1.7 ~ 3.5mm Height: 1.7 mm to 3.5 mm
SM-D906039-PB
高さ = 3.5 ~ 5.8mm Height: 3.5 mm to 5.8 mm

用途

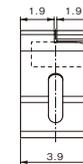
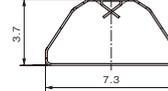
Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

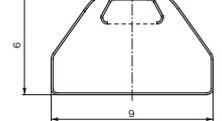
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



SM-D733735-PB



[単位 Unit:mm]

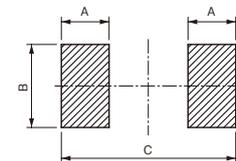


SM-D906039-PB

品番表

Product list

品番 Product code	寸法[mm] Dimensions [mm]			標準梱包数量 Standard packaging quantity	
	A	B	C	テーピング Taping	ダンボール Corrugated cardboard
SM-D733735-PB	2	3.5	7.3	2,500ヶ (リール) 2,500/reel	30,000ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 30,000/box (12 reels are packed in each box.)
SM-D906039-PB	2	3.9	9.0	1,800ヶ (リール) 1,800/reel	21,600ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 21,600/box (12 reels are packed in each box.)

ランド寸法図
Land dimensions

特性

Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.01Ω以下 0.01Ω or less	測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	5N以下 (SM-D733735-PB) 5 N or less (SM-D733735-PB) 2.2N以下 (SM-D906039-PB) 2.2 N or less (SM-D906039-PB)	測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 測定用基板上に半田付けし、製品を4.2mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.01Ω以下 0.01Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.01Ω以下 0.01Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 60℃/95%RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.01Ω以下 0.01Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.01Ω以下 0.01Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。処理温度: -40℃(3hr)~85℃(3hr) 処理時間: 12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3sec. (SM-D733735-PB)、5sec. (SM-D906039-PB)

SMコンタクト

SM contact

SM-W353038-PB



- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.15mm) Phosphor bronze (t = 0.15 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ = 1.4 ~ 2.8mm Height: 1.4 mm to 2.8 mm

用途

Applications

- ▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

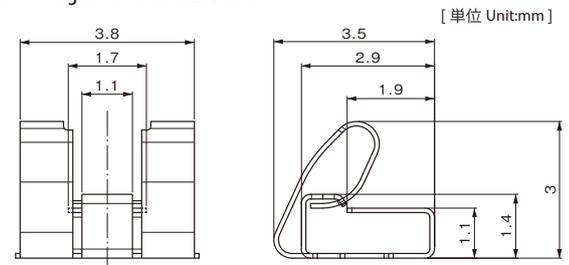
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

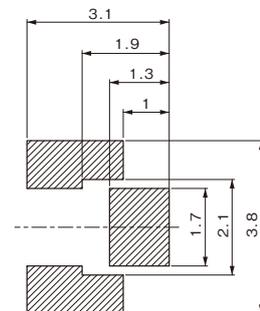
Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	3,500ヶ (リール) 3,500/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	42,000ヶ (外箱) 42,000/box	12リール/1箱 梱包 twelve reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



ランド寸法図
Land dimensions



特性

Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.01Ω以下 0.01Ω or less	測定用基板上に半田付けし、製品を2.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	2.3N以上 2.3 N or more	測定用基板上に半田付けし、製品を2.0mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr
耐湿試験 Humidity test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：60℃/95%RH 処理時間：500hr
低温試験 Low temperature test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr
ヒートショック試験 Heat shock test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。 処理温度：-40℃(3hr)~85℃(3hr) 処理時間：12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100 t0：初期高さ t1：処理後高さ t2：スパーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田：PF305 フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。 半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3sec.

SMコンタクト

SM contact

SM-E241512-PB



- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze (t = 0.08 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ = 0.7 ~ 1.4mm Height: 0.7mm to 1.4mm

用 途

Applications

- ▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

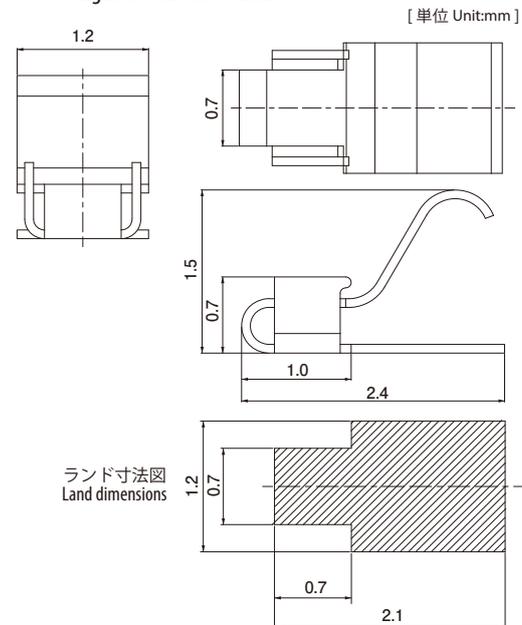
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	10,000ヶ(リール) 10,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	150,000ヶ(外箱) 150,000/box	15リール / 1箱 梱包 Fifteen reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



特 性

Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.1Ω以下 0.1Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を1.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	0.5N以下 0.5N or less	測定用基盤に半田付けし、製品を1.0mmに圧縮した時の反発力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.1Ω以下 0.1Ω or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: 85°C 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.1Ω以下 0.1Ω or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: 65°C/95% RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.1Ω以下 0.1Ω or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.1Ω以下 0.1Ω or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C(1hr)~85°C(1hr) 処理時間: 100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C(3hr)~85°C(3hr) 処理時間: 12サイクル 歪率(%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100 t0:初期高さ t1:処理後高さ t2:スパーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。半田温度: 245±3°C 浸漬時間: 5sec